

2024•高性能聚酰亚胺技术和产业应用研讨会

邀请函

会议主办单位：中国电子材料行业协会/电子化工新材料产业联盟

联合协办单位：国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

聚酰亚胺（PI）是“解决问题的能手”，得益于优异的综合性能及出色的加工性能，PI可以制成除橡胶以外的各种形式的产品，包括PI薄膜、PI纤维、PI泡沫、PI树脂、光敏PI（PSPI）、CPI等，产品类型多样性位居高分子材料前列，广泛应用于电子通信、航天航空、新能源、汽车工业等领域，对高新技术产业的重要性凸显。随着5G/6G通信、柔性OLED显示、微电子封装、集成电路封测等新技术发展，对聚酰亚胺材料的性能要求不断提升，持续推动PI材料新特性及新功能开发，下游应用领域的快速发展，带动了PI材料市场规模持续增长。

PI薄膜是PI最成熟、市场容量最大的产品形式，长期以来高性能PI薄膜市场被少数国外厂商如PIAM、钟渊化学和东丽杜邦等占据。我国PI膜的供给主要以电工级为主，高性能电子领域产品大量进口。近几年我国在柔性覆铜板用PI、柔性OLED用PI、液晶PI取向剂、折叠屏用透明聚酰亚胺薄膜、光敏聚酰亚胺等方向加快技术创新与研发，已有少数企业取得一些关键技术突破，开始导入用户企业量产应用，但产品品种、高质量规模化竞争能力仍急需加强，以保障电子信息产业供应链安全稳定。

为推动国内高性能PI材料技术创新，加快核心技术突破与产业化应用，同时促进上下游产业链企业的协同研发、科研与企业合作与技术交流、市场信息与新产品推广，电子化工新材料产业联盟将于2024年5月9日~10日在浙江省嘉兴港区举办“2024•高性能聚酰亚胺技术和产业应用研讨会”。会议将围绕集成电路封装、柔性显示、5G/6G、高铁和风电等领

域用高性能聚酰亚胺浆料、薄膜技术、产品应用研究及其原料技术、装备等方面展开研讨，产学研用技术交流。

“高性能聚酰亚胺技术和产业应用研讨会”是国内最主要的聚酰亚胺领域的行业盛会，一年一届。大会已成为推动国内高端聚酰亚胺技术创新，加快技术创新与产业化应用，产学研用深度融合的重要平台，在行业产生了广泛影响力。

一、会议安排

会议时间：2024年5月9日~10日

5月9日（星期四） 13:00~20:00 报到

15:00-17:00 参观嘉兴港区城市展厅

5月10日（星期五） 大会

9:00-12:00 2024·高性能聚酰亚胺技术和产业应用研讨会

14:00-17:00 2024·高性能聚酰亚胺技术和产业应用研讨会

18:30-20:30 晚宴

5月11日（星期六） 考察活动（拟）

二、会议地点

会议酒店：嘉兴氢港诺富特酒店

会议地址：浙江省嘉兴港区瓦山路719号

交通提示：

序号	名称	距离	简要概况
1	嘉兴南站	38.4公里	本城市主要高铁站
2	金山北站	39.2公里	上海高铁站
3	上海虹桥机场/高铁站	91公里	机场/高铁站
4	杭州萧山机场	105公里	机场
5	平湖客运中心	6.7公里	客运站

三、会议报告

- 1、中国科学院化学研究所 范琳 研究员：
高性能和功能性聚酰亚胺材料研究进展
- 2、深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 汤丹昌 总经理：
高性能聚酰亚胺薄膜工程化及产业化的探索
- 3、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 孙鹏 总经理：
先进封装用光敏聚酰亚胺技术进展
- 4、京东方科技集团股份有限公司：
聚酰亚胺在柔性显示 AMOLED 中应用与发展
- 5、株洲中车时代半导体有限公司 张鸿鑫 副部长：
功率器件用高性能光敏聚酰亚胺膜的开发应用现状与发展需求
- 6、维信诺科技股份有限公司：
柔性显示行业发展及对 PI 材料需求
- 7、广东生益科技股份有限公司 梁立：
高频柔性覆铜板用聚酰亚胺与液晶高分子的改性研究
- 8、宁波长阳科技股份有限公司 周玉波 副总经理：
浅谈用于改善人造石墨片导热系数的聚酰亚胺薄膜
- 9、武汉柔显科技股份有限公司 肖桂林 副总经理：
柔性 OLED 显示用聚酰亚胺的产业化
- 10、上海圣泉高科电子材料有限公司：
耐高温固性聚酰亚胺树脂的制备与性能研究
- 11、中国科学院兰州化学物理研究所 郭玉雄 项目副研究员：
增材制造高性能聚酰亚胺材料制备、性能及其应用研究
报告持续更新中……

四、会议邀请专家及参会代表

大会邀请中科院等行业权威的科研院所专业领域专家；华进半导体等先进封装研发中心；长电科技、通富微电、华天科技等集成电路封装企业；

京东方、华星光电、维信诺、天马等 OLED 显示企业，生益科技等 FCCL 企业、株洲中车时代等功率器件企业……等 PI 应用企业专家参会及报告交流。

深圳瑞华泰、长阳科技、柔显科技等 PI 及其原材料生产企业，专用设备、检测单位以及相关研究机构、金融、投资公司等。

五、参会报名

1、请各参会代表将参会回执于 **4月29日** 前反馈给会务组。

电子化工新材料产业联盟会员会务费 2000 元/人，非会员单位会务费 2500 元/人。会务费包括会务、餐费、资料费（不含住宿费）等。会议住宿统一安排，费用自理。

嘉兴氢港诺富特酒店房价：单（双）人间：338 元/天（含早餐）。

2、半导体、新型显示等 PI 应用企业代表免会务费，请于 **4月20日** 前向会务组提交参会名单，审核确认方可免除。

3、需要在会议上发表报告或发布新产品、新技术的企业请于 **4月20日** 前与会务组沟通，会务组将根据情况进行安排。

六、会务组联系方式

电子化工新材料产业联盟秘书处：

联系人：田杰 13910510879（微信同号）

电话：010-64476901 tj@cemia.org.cn

附：参会回执

电子化工新材料产业联盟

2024年3月25日

秘书处



附件：

2024•高性能聚酰亚胺技术和产业应用研讨会

参会回执

单位名称			
姓名	职务	手机	邮箱
参会企业类型	<input type="checkbox"/> 联盟成员 <input type="checkbox"/> 应用企业 <input type="checkbox"/> 非联盟成员		
住宿订房数量	会议酒店：嘉兴氢港诺富特酒店 会议地址：浙江省嘉兴港区瓦山路 719 号 单（双）人间：338 元/间/天（含早餐） 5 月 9 日 单人间___间 标准间___间 5 月 10 日 单人间___间 标准间___间		
参观考察	5 月 9 日 15:00~17:00 是否参加参观活动 <input type="checkbox"/> 是 _____名代表 <input type="checkbox"/> 否		
会务费 开票信息			
会务联系人	参会回执请于 4 月 29 日 前发邮件 tj@cemia.org.cn 联系人：田杰 13910510879（微信同号）		